

裕太微电子
Motorcomm

证券代码：688515



2024

“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

裕太微电子股份有限公司

ABOUT THIS REPORT

关于本报告

裕太微电子股份有限公司（以下简称“裕太微电子”或“公司”）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可，公司于2024年4月29日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

报告期内，随着中国资本市场深化改革的不断推进，“新国九条”、“科创板八条”以及“1+N”系列政策文件相继出台，公司积极响应并持续践行，始终致力于成为高速有线通信芯片的领跑者，一如既往地坚持以以太网物理层芯片为出发点，向更高层通信架构延伸的高速通信芯片的研发与创新，以高要求高标准开展工作，不断增强自主创新能力，满足高速发展的市场多样化的需求，保障最佳的服务质量和客户满意度，实现自身可持续竞争力的进一步增强，并积极传递公司价值，增强投资者信心，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。同时，公司将ESG理念与行动融入到公司发展战略、经营决策之中，以“价值创造为本”回馈广大投资者，实现与投资者的共赢发展。

目录

- 04 聚焦主营业务重视研发
提升核心竞争力
- 12 优化财务管理
提升盈利质量与运营效率
- 14 优化公司治理
强化“关键少数”规范意识
- 15 提升信披质量
构建多层次投资者沟通机制
- 16 管理层与股东利益共担共享
积极传递公司价值
- 17 其他事宜

聚焦主营业务重视研发 提升核心竞争力

裕太微电子专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，是中国大陆地区为数不多的能大规模提供百兆、千兆、2.5G 以太网系列芯片的企业。



自成立以来，公司以实现通信芯片产品的高可靠性和高稳定性为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，目标覆盖 OSI 七层模型物理层、数据链路层和网络层。

截至 2024 年上半年，公司已形成网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片和车载高速视频传输 SerDes 芯片七大产品线。目前，网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片和车载以太网物理层芯片均已规模量产。公司覆盖数通、安防、消费、电信、工业、车载等多个领域，产

品分为商规级、工规级和车规级，涵盖路由器、中继器、LED 显示屏、智能电视、无线终端、光伏、机顶盒、网络打印机、摄像头、矿业、电力系统、数据中心、工业控制、船舶、交换机、工业互联网、工业自动化、智能仪表、辅助驾驶、毫米波雷达、智能中控、激光雷达等多个应用场景。

2024 年，公司将持续专注于高速有线通信芯片的技术突破和产品创新，围绕网络数据通信和车载通信领域，不断满足客户对高性能通信芯片的需求，在持续积累中实现企业的跨越式发展，为股东创造良好回报，为社会贡献有益价值。具体包括以下几个方面：

积极拓展市场，业绩恢复增长态势

连续 6 个季度主要产品收入逐季上涨

2023 年全年到 2024 年上半年，公司主要产品收入逐季增长。公司连续 6 个季度主要产品收入实现上涨，意味着公司进入了新一轮成长周期。

主要产品收入						单位：万元
2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	
3,945.69	4,992.75	5,629.75	6,691.56	7,105.36	8,204.02	

注：公司主要产品为芯片和晶圆。

2024 年一季度

公司主要产品收入实现 **7,105.36 万元**

同比增长 **80.08%**，环比增长 **6.18%**

2024 年二季度

公司主要产品收入实现 **8,204.02 万元**

同比增长 **64.32%**，环比增长 **15.46%**

2024 年上半年整体营收同比上涨幅度达到 42.61%

报告期内，公司第一季度实现营收 7,253.15 万元，第二季度实现营收 8,214.50 万元，第二季度营收环比增长 13.25%，这也意味着公司已成功跨过低谷期，进入下一轮成长期。

相较于 2023 年，公司 2024 年上半年整体营收同比上涨 **42.61%**



2024 年上半年工规级产品营收同比上涨幅度超过 100%

报告期内，公司工规级产品营收较上年同期增长 124.02%，这个数据相较于 2023 年全年公司工规级产品整体营收同比 2022 年全年工规级产品下降 56.95% 来说，意味着从下游工规产品端的客户去库情况来看，库存压力已经得到了较大缓解，这也进一步带动公司产品端的营收恢复。

7 大新品较之去年全年营收增幅达到 32.45%

2022 年公司 3 大新品问世，新增网通以太网交换机芯片和网通以太网网卡芯片 2 条量产产品线，新品分别是单口 2.5G 网通以太网物理层芯片、5 口网通以太网交换机芯片和千兆网通以太网网卡芯片。这 3 款新品在 2023 年量产元年合计实现营收 4,199.10 万元。2023 年公司 4 大新品问世，分别是 2 口千兆网通以太网物理层芯片、8 口网通以太网交换机芯片、4+2 口网通以太网交换机芯片和千兆车载以太网物理层芯片，这 4 款新品在 2024 年量产元年实现营收。以上 7 款新品在 2024 年上半年共实现营收 5,883.62 万元，较之 2023 年全年的新品营收增幅达到 32.45%。

单口 2.5G 网通以太网物理层芯片较之 2023 年全年营收增幅达到 85.57%

2.5G 网通以太网物理层芯片为公司战略产品项目之一。2024 年第一季度，中国移动和中国电信均已发布家庭网关产品集采的通知，集采中将用到 2.5G 网通以太网物理层芯片，这也将对公司今年整体的单口 2.5G 网通以太网物理层芯片的销售带来较大增量。

2023 年单口 2.5G 网通以太网物理层芯片
实现营收 **2,085.92 万元**
2024 年上半年该产品
实现营收 **3,870.94 万元**
较之去年全年营收增长 **85.57%**

千兆车载以太网物理层芯片量产元年已上车并实现 51.32 万元营收

千兆车载以太网物理层芯片于 2023 年年底提前问世，较之百兆车载以太网物理层芯片的整体测试验证和定点周期大大缩减。2024 年作为千兆车载以太网物理层芯片的量产元年，上半年该产品即实现 51.32 万元的营收。在整体汽车智能化和网联化加深的推动下，更多的车企正在导入国产车载以太网产品系列，后续公司该类产品的营收将进一步走强。

围绕七大产品线持续整合产业资源 保持行业先进性

2024 年，公司将抓住国家战略新兴产业和未来产业发展的大机会，持续整合产业资源，逐步向上层网络处理产品拓展，重点布局新能源汽车、WiFi7、数据中心、信创等多个领域，形成系列化的芯片产品和解决方案，丰富产品布局，持续提升百兆、千兆、2.5G 产品性能。



产品线	截至 2023 年进展	2024 年及未来三年重点规划
网通以太网物理层芯片	百兆、千兆、2.5G 芯片均已规模量产	百兆、千兆、2.5G 芯片实现产品项目多样化，预计 2026 年实现 10G 芯片量产出货
网通以太网交换机芯片	5 口、4+2 口及 8 口芯片量产出货	16 口和 24 口交换机芯片预计 2024 年年底出样片，同时实现单口速率千兆 /2.5G 产品种类多样化
网通以太网网卡芯片	千兆芯片已规模量产	补充千兆芯片产品种类
车载以太网物理层芯片	百兆芯片已规模量产，千兆芯片已量产出货	百兆、千兆产品规模量产出货
车载以太网交换机芯片	第一代车载以太网交换机芯片研发中	预计 2025 年年初出样片
车载网关芯片	第一代车载网关芯片预研中	实现技术成果突破
车载高速视频传输 SerDes 芯片	第一代车载高速视频传输 SerDes 芯片研发中	预计 2025 年年底出样片

保持研发投入力度坚持创新 持续提升自主研发能力

集成电路设计企业的竞争力主要体现在其研发能力和技术水平，公司作为专业的芯片设计企业，致力于高速有线通信芯片的研发和产业化，坚持以自主研发为导向，建立了完善的自主研发体系。目前已形成高性能 SerDes 设计技术、高性能 ADC 设计技术、高性能 DAC 设计技术、SOC 芯片集成技术、低抖动锁相环设计技术等多个方面的核心技术能力。

公司所掌握的关键核心技术具体如下：

序号	核心技术名称	主要用途	应用产品
1	高性能 SerDes 设计技术	物理层与数据链路层之间的板级高速通信接口	全品类
2	高性能 ADC 设计技术	完成物理层模拟信号的数字采样	车载 / 网通以太网物理层芯片
3	高性能 DAC 设计技术	完成物理层模拟信号的生成	车载 / 网通以太网物理层芯片
4	高速数字均衡器和回声抵消器	完成数字域接收信号的恢复和发射信号的回声消除	车载 / 网通以太网物理层芯片
5	高可靠性浪涌保护电路设计技术	提高物理层芯片信号接口的可靠性	车载 / 网通以太网物理层芯片
6	低抖动锁相环设计技术	生成宽范围低抖动的时钟参考	全品类
7	宽频带模拟回声抵消技术	完成模拟域发射信号的回声消除	车载 / 网通以太网物理层芯片
8	超长距离以太网传输方法	通过私有物理层协议完成超长距离（大于 400 米）以太网传输	车载 / 网通以太网物理层芯片、车载 / 网通以太网交换机芯片
9	线缆损伤检测技术	通过检测放松信号的回波，对线缆状况（开路或者短路）进行检测	车载 / 网通以太网物理层芯片
10	SOC 芯片集成技术	SOC 芯片中低功耗设计与验证方法学，信号与电源完整性设计验证方法学，提高芯片质量	车载 / 网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载网关芯片
11	1588 时钟同步技术	实现以太网网络中不同物理层节点之间的精确时间同步	车载 / 网通以太网物理层芯片、车载 / 网通以太网交换机芯片、车载网关芯片

序号	核心技术名称	主要用途	应用产品
12	MACsec 通信安全技术	实现通过身份认证、数据加密、完整性校验、重播保护等功能保证以太网数据帧的安全性	车载 / 网通以太网物理层芯片、车载 / 网通以太网交换机芯片、车载网关芯片
13	小数分频锁相环设计技术	实现输出时钟与参考时钟非整数倍的应用	全品类
14	LDPC/RS 等信道编解码及其低功耗实现技术	实现信道编解码，降低物理层信息传输误码率，并降低实现功耗	车载 / 网通以太网物理层芯片
15	TSN 时间敏感网络技术	提供确定性的网络连接，实现网络传输时间同步，保持低时延，低时延抖动	车载 / 网通以太网交换机芯片、车载网关芯片

2024 年上半年，公司累计研发投入 **13,456.50 万元**
较之去年上半年同比增长 **37.00%**，占当期营业收入的比例为 **87.00%**
新增申请发明专利 **7 项**，累计申请发明专利 **132 项**

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增（个）		累计数量（个）	
	申请数	获得数	申请数	获得数
发明专利	7	13	132	36
实用新型专利	1	2	24	20
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	5	5
其他	1	4	70	53
其中：境外发明	1	4	29	12
其中：集成电路布图设计	0	0	41	41
合计	9	19	231	114

重视人才发展战略 优化激励机制保持科研团队稳定

公司不断加速战略升级和体系迭代，为发挥研发体系战略支点的先锋作用，提升核心竞争力，打造更稳健的发展底盘，成立高等技术研究院、中央工程部进行前瞻技术研究和关键技术能力突破，同时汇聚研发各模块资源成立产品研发部，发挥枢纽作用，强化各模块专业技术能力、协同作战能力、产品交付能力等综合实力，以实现公司发展的新突破。

公司核心团队成员大多拥有十余年的实战经验，领导并组建了由多名通信芯片行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。凭借对以太网及相关通信协议和芯片设计技术的深刻理解，公司建立了成熟有效的多学科协同研发机制和研发人才培养机制，形成了独有的核心人才优势和特色。

截至 2024 年 6 月 30 日
公司研发人员共 **251 人**
占公司总人数的 **69.15%**

公司高度重视对研发团队的投入和激励。2024 年，公司将继续坚持“一流的人才，一流的业绩，一流的回报”的人才理念，3 月，经董事会审议通过，公司将回购部分股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。未来，公司拟结合市场情况、公司经营目标筹划股权激励计划 / 员工持股计划，授予部分研发人员，形成公司、股东、员工多方的共建共享共担合力。

截至 2024 年 6 月 30 日

公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 **603,649 股** 占公司总股本 80,000,000 股的比例为 **0.7546%**，支付的资金总额为人民币 **39,989,549.23 元**，已接近预计回购金额上限 40,000,000 元

在强化自主研发的基础上，2024 年上半年，公司进一步开展与各高等院校、科研机构的合作，促进人才培养、技术创新和知识共享，培养行业新生力量，不断提升科技创新影响力，包括：

公司与南京邮电大学共同创办以太网传输芯片研发中心；

公司参与了 2024 年台北国际电脑展，接待了百名客户，并获取了新的海外潜在商机、补充了下一代产品路线图，为公司后续挖掘高端产品的应用市场提供了思维空间；

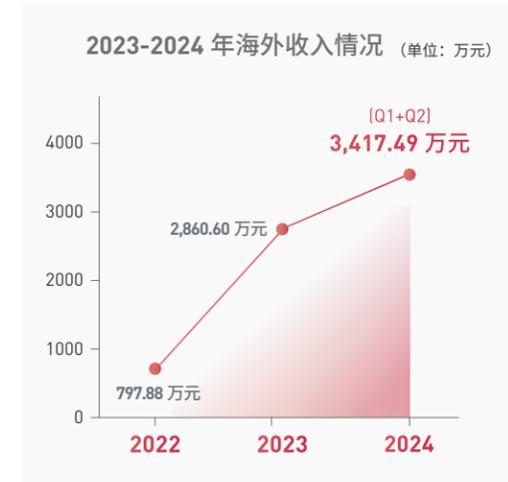


公司骨干获取 IEEE 802.3 会员资格，深度参与 IEEE 802.3 多个课题组的标准讨论；

公司核心骨干受邀参加“苏州市汽车芯片产业链供需对接会暨苏州高新区消费电子及新型显示产业沙龙活动”，展示了新能源汽车高速有线通信芯片解决方案。

加强品牌建设 & 营销网络建设 积极拓展海内外市场

2024 年，公司将在继续巩固深化国内业务的同时，重点拓展海外业务，积极拓宽业务版图，由立足境内的科技型创业公司向全球化的商业集团转变。



加快市场营销团队能力建设

加强市场营销部门自身专业素质培养，增强客户服务能力；

加强市场宣传力度

利用线上与线下相结合的传播方式，提升品牌宣传覆盖力，开展更有针对性的品牌宣传活动，扩大品牌影响力；

加速海外客户市场渗透

2022 年公司设立新加坡发展中心，2023 年实现海外收入 2,860.60 万元，发展势头良好，2024 年上半年，公司海外营业收入金额为 3,417.49 万元，已超过 2023 年全年的海外营业收入总额。公司将通过多种方式持续加大发展海外业务，开辟海外的蓝海市场，支撑公司业务的快速发展。

围绕产业推动战略资源并购 产融结合夯实竞争优势

公司坚定聚焦主业，将从技术成熟度、成长性空间、产业链生态等多个维度寻找不同发展阶段的企业，使用包括但不限于并购重组等资本运作方式不断整合资源，以期稳步推进围绕主营业务的相关产业集群发展，充分发挥业务间的协同效应，提高公司整体竞争力。

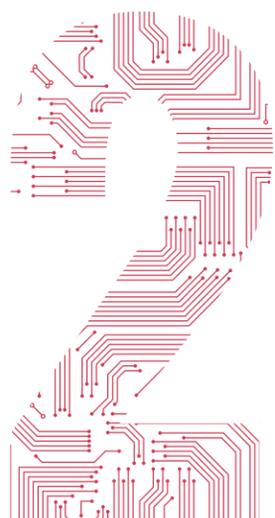
(1) 公司积极加入了国际领先的车载非对称标准组织 Automotive SerDes Alliance (ASA)；

(2) 公司成为中国智能网联汽车产业创新联盟 (CAICV) 的会员，并加入国创中心的汽车芯片标准研究工作组，致力于与国内产业伙伴一同推动车载技术的发展和成熟；

(3) 公司已加入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会，后续也将开拓更多信创业务；

(4) 公司 YT8011A 产品荣获 2024 “汽车芯片编辑选择奖”，同时该产品已纳入苏州市信息技术创新产品应用推广目录。





优化财务管理 提升盈利质量与运营效率

01
加强与现有客户的深度合作，在提升存量市场占有率的同时及时满足客户新需求，与客户一同打造优秀的供应链生态；

加大客户多元开拓，提升资产盈利质量

公司产品线不仅仅局限于以太网物理层芯片，通过持续不断的研发正在向 OSI 模型上层衍生。同时，以太网芯片的应用场景广阔，除国内外，海外的应用场景和客户范围更为广泛。

02
积极开拓新客户，扩大数据通信市场份额，重点拓展车载芯片市场；积极布局数据中心的相关市场，通过战略合作项目落地等方式加快客户多元化进程；

2024 年，公司将加速新产品研发，加大海内外客户开拓力度，努力提升资产收益率，具体包括三个方面。

03
在七条产品线的基础上继续通过拓宽下游应用新场景，不断丰富和优化产品结构，使公司数据通信领域相关产品逐渐从家庭应用进入到企业应用领域。

2024 年上半年度公司对与主营业务相关的前五大客户销售收入约 **9,240.84 万元** 占当期主营业务收入的比率为 **59.77%**

优化财务管理能力，提升内部运营效率

财务管理能力影响公司日常运营效率和整体经营效益成果。2024 年，公司将进一步加强财务管理优化提升工作，持续提高运营效率，具体包括：

- (1) 推动业财融合，加强财务管理的信息化建设，优化计划性支出的前瞻性与过程管理，为管理层预判提供更为精准的财务支持；
- (2) 应收账款周转率方面，公司将加强信用评估机制，优化信用政策、建立良好的催收流程，做好订单回款收款管理工作，持续优化公司现金流；
- (3) 存货周转率方面，加强供应链精细化管理，不断提高库存管理水平，坚持“经销为主，直销为辅”的销售模式快速实现市场渗透。

截至 2024 年上半年
公司整体资产负债率 **5.97%**
应收账款余额为 **0.55 亿元**
应收账款周转率为 **5.41**
存货余额为 **1.60 亿元**
存货周转率为 **1.05**

合理规划存量资金，提高资金使用效率

公司高度重视对存量资金的合理规划和使用，2024 年，公司将进一步加强现金管理，通过以下方式提高资金使用效率，更好地实现资金的保值增值。

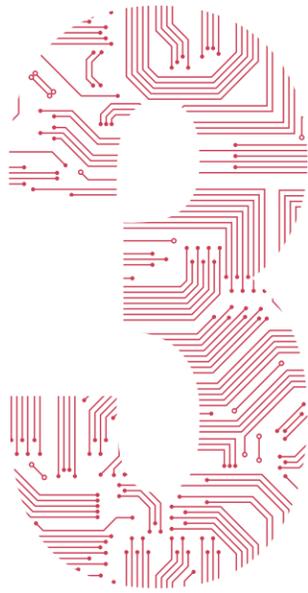
在自有资金管理方面，以资金安全性、流动性为前提，运用部分闲置自有资金投资具有一定收益的银行理财产品；在募集资金管理方面，在确保不影响募投项目建设及募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益。

截至 2024 年上半年
公司货币资金余额约为 **67,007.23 万元**
交易性金融资产余额 **80,034.63 万元**

审慎使用募集资金，加强募投项目管理

2024 年，公司将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按计划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。





优化公司治理 强化“关键少数”规范意识

公司高度重视公司治理结构的健全、有效。目前，公司已建立以股东大会、董事会及专门委员会、监事会、高级管理人员为核心的法人治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了组织保证和制度保障。

2024年上半年，公司继续优化公司治理，加强投资者交流，维护和保障全体股东的合法权益。具体的重点工作和计划如下：



推动内部治理机制完善

2024年，公司将以ESG（即环境、社会及治理）作为管理的抓手，推动以董事会为责任主体的ESG治理机制：董事会下设ESG工作小组，逐步搭建/完善ESG管理体系，推进ESG实践，推动公司长期可持续发展。



落实独立董事制度改革要求

目前，公司已落实独立董事制度改革的要求，并成立独立董事工作组，以独立董事月度例会、独立董事专门会议及不定期沟通等形式保障独立董事及时了解公司发展经营情况。

2024年上半年，公司共召开4次独立董事例会，及时、充分向独立董事汇报公司经营情况和重大事项。同时，公司为独立董事履职提供全面而便利的条件，并指定董事会办公室作为沟通对接部门，切实保障独立董事的知情权，方便独立董事开展每年不少于15日的现场工作。



提升董监高等规范意识

2024年上半年，公司不断强化“关键少数”规范意识，提高日常学习和培训的深度和频率：

(1) 为强化董监高等相关人员的专业素养，2024年上半年，公司组织参与交易所专题培训14人次、参与证监局、上市公司协会等其他专题培训4人次，主要内容涵盖上市公司高质量发展、公司治理和董监高履职、投资者关系管理、合规运作、“科八条”政策解读等专题培训，出席率达到100%。

(2) 董事会办公室共刊发6期《公司治理月报》并及时发送给董监高及相关人员，确保“关键少数”了解最新的法律法规，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。《公司治理月报》包括行业信息、政策制度、典型案例、公司治理和市值分析等多个模块。

提升信披质量 构建多层次投资者沟通机制

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司亦重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、集体业绩说明会、公司官网、公司微信公众号、路演/反路演等方式构建多平台、多层次的投资者沟通渠道，便于投资者了解公司。2024年，公司持续增强公司信息透明度，坚持简明清晰、通俗易懂的基本原则，保护中小股东权益，通过以下方式优化信息披露及投资者关系管理工作：



提高信披可读性

进一步探索丰富公司信息披露的表现和传播形式，通过灵活多样的方式向广大投资者展示公司经营情况、研发进展、产品情况，突出关键信息点，减少投资者阅读负担：

- (1) 公司采用一图读懂等可视化形式对2023年年度报告及2024年一季度报告进行更直观地解读，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略；
- (2) 在公司《2023年度芯片设计专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会》及投资者调研活动中采用PPT+视频等方式，通过数据图表、情景化展示等让信息更直观易懂；
- (3) 披露《裕太微电子股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况。



信息获取便捷性

在法定信息披露媒介的基础上，公司通过官方网站、官方公众号等方式，增加与投资者沟通交流的平台，公司设有企业发展历程展示场所，丰富投资者获取信息的渠道，有效传递公司价值、树立市场信心：

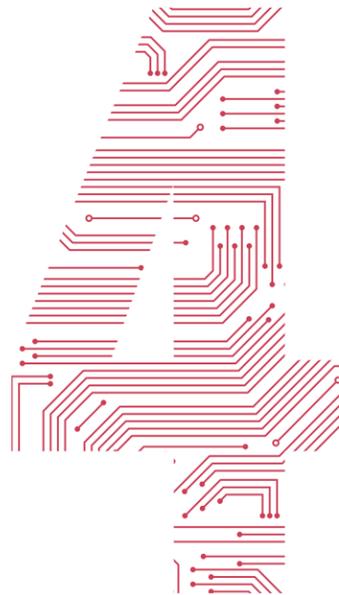
- (1) 利用“裕太微电子”官方公众号传播，向投资者及时推送公司动态、传递前沿行业动态等信息；
- (2) 优化公司官网“投资者关系”栏目，该栏目下设投资者教育、公司公告、股票信息、投资者联络、投资者关系五个子栏，保障投资者知情权，与投资者保持密切沟通。

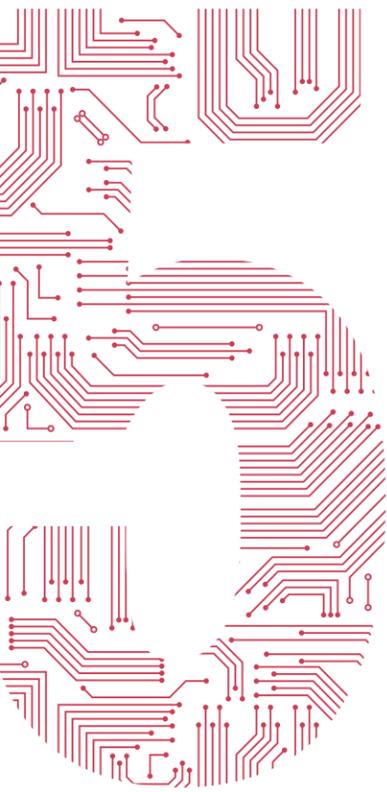


加强投资者沟通

2024年上半年，公司安排一系列投资者关系活动，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系：

- (1) 通过“上证路演中心”平台举办1次业绩说明会，据Wind统计累计接待其他调研机构406家；
- (2) 披露上网文件55份，发布调研活动记录40份；
- (3) e互动问答114条，回复率100%；
- (4) 接听投资者电话106个，同时通过公开邮箱等方式与投资者保持充分沟通。





管理层与股东利益共担共享 积极传递公司价值

2024年，公司将继续完善企业管理模式、持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，同时积极引导“关键少数”承担相应责任，推动公司的长期稳定发展。



建立常态化股权激励机制 管理层与股东利益一致

公司高管薪酬由基础薪酬、绩效薪酬两个部分组成。2024年，公司将积极进一步优化管理层薪酬机制并引入长效激励机制，促进管理层与股东利益的深度融合。

通过建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。



兼顾公司发展与股东利益 优先现金分红回馈投资者

公司充分重视对股东的合理投资回报，制定了《公司上市后三年内股东分红回报规划》。公司将在满足现金分红条件的前提下，优先采用现金分红的方式进行利润分配，保持利润分配政策连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。



积极传递公司价值，增强投资者信心 促进价值回归

自公司股票上市之日起3年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，且公司、实际控制人及其一致行动人、董事（不含独立董事）、高管同时满足法律法规、规范性文件等关于回购、增持条件的，公司及相关主体将实施相关稳定股价的措施。

2024年，公司将根据资本市场情况形成股价稳定机制，明确股价短期跌幅过大、跌破发行价、跌破净资产等作为启动条件，设立相应的触发机制，并采取相应的股价维稳措施，如股票回购等，以稳定股价并增强投资者信心。

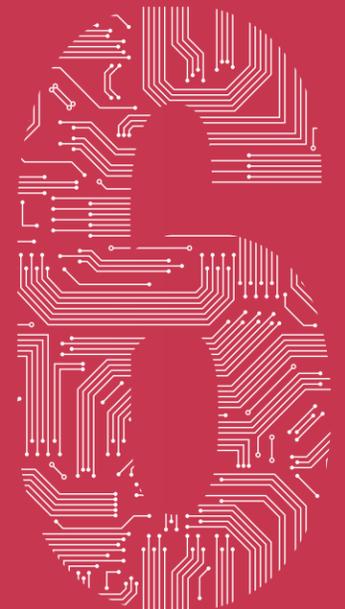


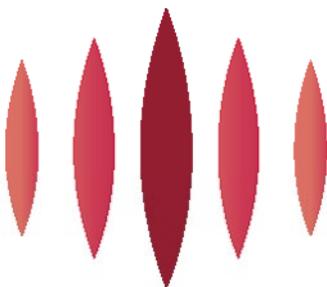
其他事宜

公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

裕太微电子股份有限公司董事会
2024年8月28日





裕太微电子
Motorcomm



电话：021-50561032 传真：021-50561703

邮箱：ytdz@motor-comm.com

地址：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼

上海市浦东新区新金桥路 2000 弄 B 栋 9-10 楼

苏州市高新区金山东路 78 号 202 室